

ランチョンセミナー（先着 75 名弁当付）開催のご案内

開催日： 2019 年 9 月 4 日（水）～5 日（木）

ポスター発表の昼休憩時に、精密工学関連分野で高い技術をお持ちの企業より、各企業の独自技術や新製品に関するご紹介を、1 社 15 分でご講演いただきます。昼食をとりながら、落ち着いた雰囲気でお聴講いただけます。なお聴講者の先着 75 名に、お弁当を無料配布します（事前に弁当引換券の受取が必要です。下記ご参照ください）。学生会員の方の聴講も大歓迎です。各企業の先端技術情報を短時間で得る絶好の機会ですので、是非ご参加ください。

企画： 2019 年度秋季大会実行委員会

日時・会場：

- 9 月 4 日(水) 12:00～12:45 総合研究棟 3F I 室
- 9 月 5 日(木) 12:00～13:00 総合研究棟 3F I 室

弁当引換券の受取方法：

9 月 4 日、5 日 9：30～12：00 の間に総受付近くの特設ブースにて当日分の「ランチョンセミナー弁当引換券」を先着 75 名配布しますので、ご希望の方は予め引換券を受取の上、上記セミナー会場内にて弁当と交換ください。なお本引換券の配布は、学術講演会への参加登録者に限らせていただきます。

セミナー内容

発表日・場所	発表時間	講演企業	講演題目
9 月 4 日(水) 総合研究棟 3F I 室	司会： 三浦 憲二郎，白杵 深（静岡大学）		
	12:00-12:15	パルステック工業(株)	ポータブル型 X 線残留応力装置および非接触硬さムラスキャナの測定方法と測定事例
	12:15-12:30	東芝機械(株)	東芝機械の超精密加工技術について
	12:30-12:45	DMG 森精機(株)	DMGMORI における工作機械の最新技術
9 月 5 日(木) 総合研究棟 3F I 室	司会： 三浦 憲二郎，白杵 深（静岡大学）		
	12:00-12:15	工作機械技術振興財団	工作機械技術振興賞，研究助成の概要と募集
	12:15-12:30	三鷹光器(株)	小型部品の非接触内径測定
	12:30-12:45	ピーアイ・ジャパン(株)	精密位置決め業界をリードする PI 社の技術と製品の紹介
	12:45-13:00	住友電気工業(株)	高能率・高精度加工を実現する最新の切削工具

参加費： 本セミナーのみの参加の場合は参加費無料(会員，非会員を問いません)。

ただし、学術講演会、シンポジウムへも参加する場合は、別途参加登録費が必要となります。